

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Pakkethoeveelheid	Diepte	Breedte
-----------------	------	-----------	-------------------	--------	---------

24830-005	Warmtegeleider	Gevallen	1	22 mm	22 mm
-----------	----------------	----------	---	-------	-------

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE